

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce
Přehled publikační činnosti

Student: **Ing. Martin Hirman**

Školitel: doc. Ing. František Steiner, Ph.D.

Seznam publikovaných prací:

Publikace výsledků na konferenci Elektrotechnika a informatika:

2014:

- 1 - HIRMAN, Martin, Mechanická pevnost vodivých lepidel ve srovnání s pájecími slitinami. Elektrotechnika a informatika 2014: Část 1., Elektrotechnika. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 29–32. ISBN 978-80-261-0367-7.

2015:

- 2 - HIRMAN, Martin, Závislost množství elektricky vodivých lepidel na mechanické pevnosti lepeného spoje. Elektrotechnika a informatika 2015: Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 43 46. ISBN 978-80-261-0514-5

Publikace výsledků na konferenci International Spring Seminar on Electronics Technology:

2014:

- 3 - HIRMAN, Martin, Karel RENDL, Frantisek STEINER a Vaclav WIRTH. Influence of reflow soldering profiles on creation of IMC at the interface of SnBi/Cu. In: 2014 37th International Spring Seminar on Electronics Technology. IEEE, 2014, s. 147-151. ISBN 978-1-4799-4455-2. DOI: 10.1109/ISSE.2014.6887582. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6887582>

2015:

- 4 - HIRMAN, Martin a Frantisek STEINER. A comparison of the shear strength of conductive adhesives and soldering alloys. In: 2015 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2015, s. 167-172. DOI: 10.1109/ISSE.2015.7247983. ISBN 978-1-4799-8860-0. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7247983/>

2016:

- 5 - HLINA, Jiri, Karel HROMADKA, Jan REBOUN, Martin HIRMAN a Ales HAMACEK. Adhesion improvement of Thick Printed Copper film on alumina substrates by controlling of oxygen level in furnace. In: 2016 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2016, s. 22-26. DOI: 10.1109/ISSE.2016.7563154. ISBN 978-1-5090-1389-0. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7563154/>
- 6 - HIRMAN, Martin a Frantisek STEINER. Influence of electrically conductive adhesive quantity on insulation distance and shear strength of glued joints. In: 2016 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2016, s. 134-139. DOI: 10.1109/ISSE.2016.7563175. ISBN 978-1-5090-1389-0. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7563175/>

- 7 - BENESOVA, Andrea, Jan SIMOTA, Martin HIRMAN, Jiri NAVRATIL, Jiri TUPA a Frantisek STEINER. Connection technologies quality improving. In: 2016 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2016, s. 342-347. DOI: 10.1109/ISSE.2016.7563217. ISBN 978-1-5090-1389-0. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7563217/>

2017:

- 8 – HIRMAN Martin, Jiri NAVRATIL, Radek SOUKUP, Ales HAMACEK a Frantisek STEINER. Influence of Flexible Substrate Roughness with Aerosol Jet Printed Pads on the Mechanical Shear Strength of Glued Joints. In: 2017 40th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2017, s. 100-101. ISBN 978-619-7066-15-9
- 9 - HLÍNA Jiri, Jan REBOUN, Martin HIRMAN a Ales Hamacek. Comparison of Copper and Silver Thick Film on Alumina Substrates Properties. In: 2017 40th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2017, s. 34-35. ISBN 978-619-7066-15-9
- 10 – FRIDRICHOVSKY Martin, Frantisek STEINER a Martin HIRMAN. Comparison of the Characteristics of PCB Protective Coatings. In: 2017 40th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2017, s. 136-137. ISBN 978-619-7066-15-9
- 11 – NAVRATIL Jiri, Jan REBOUN, Tomas RERICHA, Radek SOUKUP, Martin HIRMAN a Ales HAMACEK. Nanoparticle based ink printed chip interconnections. In: 2017 40th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2017, s. 102-103. ISBN 978-619-7066-15-9

Publikace výsledků na konferenci International Conference on Applied Electronics:**2015:**

- 12 - HIRMAN, Martin a Frantisek STEINER. Influence of electrically conductive adhesive amount on shear strength of glued joints. In: 2015 International Conference on Applied Electronics (AE). IEEE, 2015, s. 53-56. ISBN: 978-8-0261-0385-1. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7301055/>

Publikace výsledků na konferenci IMAPS Flash Conference – Czech and Slovak chapter:**2015:**

- 13 - HIRMAN, Martin a Frantisek STEINER. Influence of electrically conductive adhesive amount on shear strength of glued joints on flexible substrates. In: 2015 International flash conference IMAPS: Czech and Slovak chapter. IEEE, 2015, s. 30-31.

2016:

- 14 - STEINER Frantisek, Jakub STUNA a Martin HIRMAN. Temperature stable solder pastes - properties and reliability. In: 2016 IMAPS Flash Conference: 2nd International Microelectronics Assembly and Packaging Society Flash Conference (IMAPS 2016). IEEE, 2016, s. 44-45. ISBN 978-80-214-5416-3.

Publikace výsledků na konferenci Electronic System-Integration Technology Conference:**2016:**

- 15 - STUNA, Jakub, Frantisek STEINER a Martin HIRMAN. Properties of temperature stable solder pastes. In: 2016 6th Electronic System-Integration Technology Conference (ESTC). IEEE, 2016, s. 1-6. DOI: 10.1109/ESTC.2016.7764724. ISBN 978-1-5090-1402-6. Dostupné z: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7764724/>

Publikace výsledků na konferenci IMAPS Poland Conference:**2016:**

- 16 - HIRMAN, Martin a Frantisek STEINER. Solder pastes quantity vs. mechanical strength. 40th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference. ISBN 978-83-932464-2-7. Dostupné z: http://www.imaps2016.pwr.edu.pl/wp-content/IMAPS_Poland_2016_Book_of_abstracts.pdf

Publikace výsledků v neimpaktovaném časopisu Electroscope:**2016:**

- 17 - STEINER Frantisek, Jakub STUNA a Martin HIRMAN. Temperature stable solder pastes - properties and reliability. In: 2016 Electroscope . 2016, s. 1-8. ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=article&id=476:temperature-stable-solder-pastes-properties-and-reliability&catid=59:2016-12-12-09-18-59&Itemid=56

Publikace výsledků v časopisu se SJR faktorem Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science:**2016:**

- 18 - BENESOVA, Andrea, Jan SIMOTA, Martin HIRMAN, Jiri NAVRATIL, Jiri TUPA a Frantisek STEINER. Methodologies to Improve Experimental Research Processes in Soldering Technology. Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 60, No. 4, pp. 237-244, 2016. DOI: 10.3311/PPEe.9684

Publikace výsledků v impaktovaném časopisu Journal of Electrical Engineering:**2016:**

- 19 - HIRMAN, Martin a Frantisek STEINER. Shear Strength of Conductive Adhesive Joints on Rigid and Flexible Substrates Depending on Adhesive Quantity. Journal of Electrical Engineering. DOI: 10.1515/jee-2016-0025. ISSN 1339-309x. Dostupné z: <http://www.degruyter.com/view/j/jee.2016.67.issue-3/jee-2016-0025/jee-2016-0025.xml>

Publikace výsledků v impaktovaném časopisu Soldering & Surface Mount Technology:**2017:**

- 20 - HIRMAN, Martin a Frantisek STEINER. Optimization of solder paste quantity considering the properties of solder joints. Soldering & Surface Mount Technology. 2017, s. 15-22. DOI: 10.1108/SSMT-10-2016-0025. ISSN 0954-0911. Dostupné z: <http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/SSMT-10-2016-0025>

Seznam vystoupení studenta na vědeckých konferencích:**2014:**

- Ústní prezentace článku č. 1 na konferenci Elektrotechnika a Informatika, Nečtiny, Česká republika

- Posterová prezentace článku č. 3 na mezinárodní konferenci International Spring Seminar on Electronics Technology, Drážďany, Německo

2015:

- Ústní prezentace článku č. 2 na konferenci Elektrotechnika a Informatika, Nečtiny, Česká republika
- Posterová prezentace článku č. 4 na mezinárodní konferenci International Spring Seminar on Electronics Technology, Eger, Maďarsko
- Ústní prezentace článku č. 12 na mezinárodní konferenci Applied Electronics, Plzeň, Česká republika
- Ústní prezentace článku č. 13 na mezinárodní konferenci IMAPS Flash, Brno, Česká republika

2016:

- Posterová prezentace článku č. 6 na mezinárodní konferenci International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, Česká republika
- Posterová prezentace článku č. 15 na mezinárodní konferenci Electronic System-Integration Technology, Grenoble, Francie
- Posterová prezentace článku č. 16 na mezinárodní konferenci IMAPS Poland, Wałbrzych, Polsko

2017:

- Posterová prezentace článku č. 8 na mezinárodní konferenci International Spring Seminar on Electronics Technology, Sofie, Bulharsko + ocenění „Excellent Poster Award for Young Scientist“
- Posterová prezentace článku č. 11 na mezinárodní konferenci International Spring Seminar on Electronics Technology, Sofie, Bulharsko

Potvrzení školitele:

Potvrzuji, že přehledy publikační činnosti a vystoupení studenta jsou úplné a správné.

Datum: 6.6.2017



.....
Podpis školitele